

직무구분	세부직무
패키지개발	<div><div>■ 차세대 반도체 패키지 제품개발</div><div>- 2.5D High Performance 향 Large Size PKG 개발</div><div>- 3D TSV-PKG(HBM, SiP), FoWLP(Fan-out Wafer Level PKG) 등 차세대 PKG 개발</div><div>- PKG 구조분석, 신뢰성 평가, Small Form factor 개발(통계적 분석)</div></div>
	<div><div>■ Chip 재배선 공정 개발(FAB 공정)</div><div>- Advanced PKG를 위한 재배선 공정(FAB공정) 개발</div><div>- Photo, Etch, CMP, CVD, Electro-plating 등</div></div>
	<div><div>■ Memory, Foundry 패키지 설계</div><div>- HBM, 2.5D, 3D, WLP PKG 설계</div><div>- Si interposer 설계 및 Chip RDL 설계</div><div>- Fine Pitch Integration</div></div>
	<div><div>■ 패키지 Assembly 공정 개발</div><div>- FOWLP, 3D SIP, 2.5D 제품 공정개발</div><div>- 3D Stacking (TC bonding, Hybrid bonding) 기술 개발 *TC bonding: Thermal Compression bonding</div><div>- Laser sawing, Laser bonding 기술</div><div>- MUF, Encapsulation 공정개발 *MUF: Molded Underfill</div></div>
	<div><div>■ 패키지 소재개발</div><div>- Fab 소재 개발(Photoresist, PID, Slurry, Etchant, Plating Chemical) *PID: Photoimageable dielectric</div><div>- PKG 및 Substrate 소재 개발 (Solder, Heat Sink, Film, EMC 등)</div></div>
설비개발 (기구설계,S/W)	<div><div>■ Electrical Simulation (Signal Integrity, Power Integrity)</div><div>- Chip Level (Chip 내부) SI/PI</div><div>- PKG Level (Chip-Wire-PCB) SI/PI</div><div>- SET Level (PKG-Board) SI/PI</div><div>- 5G-AiP (Antenna in PKG) module</div></div>
	<div><div>■ Thermal Simulation</div><div>- High-stack PKG On-Chip Thermal</div><div>- System Level Thermal 분석</div><div>- High Power Thermal 측정 및 Modeling</div></div>
	<div><div>■ Mechanical Simulation</div><div>- 이종소재 계면 예측기술</div><div>- 이종소재의 다층 적층 modeling 기술</div></div>
품질관리 신뢰성평가	<div><div>■ 반도체 설비 요소기술 개발</div><div>- 설비 진동 측정/분석을 통한 Solution 개발</div><div>- Motor/공압/구동 Unit 활용 설비 개발</div></div>
	<div><div>■ 고정밀/고속 Motion 설계/제어/분석</div><div>- Motion 제어, SW Architecture</div><div>- Job Scheduling Logic 구현, Assignment / Routing 최적화</div><div>- Job Scheduling/Assignment/Routing Logic 설계</div></div>
TEST 인프라 개발	<div><div>■ 불량검사 알고리즘 개발</div><div>- Machine Learning을 활용한 이미지 프로세싱</div></div>
	<div><div>■ 신뢰도 및 물성/특성 분석</div><div>- PKG신뢰성 평가 및 분석</div><div>- 소재 열화 평가 및 Simulation</div><div>- 가속 신뢰성 평가법 개발</div><div>- SEM, TEM등 분석장비를 활용한 반도체 불량 분석</div></div>
	<div><div>■ TEST 회로설계</div><div>- 반도체 DFT Logic 설계(Design For Test)</div><div>- Test Board 회로설계 및 Simulation</div><div>- High Speed Signal, ASIC설계</div></div>
	<div><div>■ TEST System 개발</div><div>- High Bandwidth Memory Test System 개발</div><div>- 차세대 PCIe 기반 Solution제품 Test System 개발</div><div>- FPGA Firmware 개발 및 핵심 IP 내재화 설계</div></div>